

感應耦合式電漿蝕刻系統

(Inductive Couple Plasma Etcher, ICP Etcher)

儀器簡介

感應耦合式電漿蝕刻系統是採用射頻電源注入設計在腔體周圍的電極線圈，藉由電感耦合增加電子的運動距離而在高真空環境下激發出高密度電漿。此機台為乾式深蝕刻矽材之設備，搭配C4F8、SF6氣體與低溫載盤來建置Bosch Deep Si Etching 方式的深蝕刻矽基材參數。

- ❖ 全名: 感應耦合式電漿蝕刻系統 (ICP Etcher)
- ❖ 位置: class 100
- ❖ 機台負責人: 許倬綸
- ❖ 負責人緊急聯絡電話: (O) 03-5726100 ext 7651 (H) _____
- ❖ 機台工程師: 許倬綸 先生
- ❖ 工程師代理人: 薛富國 先生
- ❖ 工程師緊急聯絡電話: (O) 03-5726100 轉 7557 (H) _____
- ❖ 機台使用之化學品:
 - (1) 大宗氣體: **Ar, O2, He, SF6, C4F8**
- ❖ 製程模式或反應腔:
 - (1) ICP Etcher
- ❖ 反應腔真空度範圍: 12 ~ 40 mtorr (待機: 0.2 mtorr)
- ❖ 尾氣排放物種: Si, F, S, O
- ❖ 尾氣排放有無獨立之 Local Scrubber: 有, 廠務端提供
- ❖ 反應腔溫度範圍: 175°C (MAX)
- ❖ 冷卻系統種類: He, 機台端 chiller

- ❖ 其他特殊危害: _____
- ❖ 製造商或代理商: 辛耘企業股份有限公司
- ❖ 代理商工程師: 0987-238571